

MMD-650 プリント基板メッキバリ面取り機

4side Copper Plating Edge Beveling Machine

プリント基板メッキバリ面取り機 **MMD-650**
4side Copper Plating Edge Beveling Machine

0.1から1.6mmまでのメッキされた基板の 端面バリ取り加工が可能になりました。

Realized to perform the auto-beveling operation for buildup panel (0.1~1.6t).

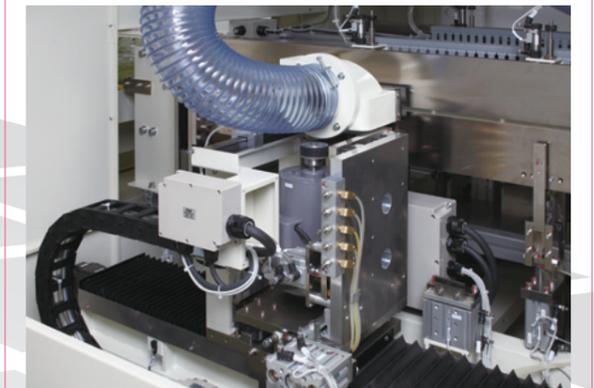
多層構造のプリント基板を作製する方法で、ビルドアップ工法が多く使用されています。多層積載、メッキ工程を繰り返すことで、端面にメッキされた銅が積載されることから、多くの工程内でエッジからのメッキバリ、メッキはがれが、不良発生の原因になっています。端面バリ取り加工では、メッキ部分だけの切削が要望されていました。MMD-650は、業界の要望にこたえるべく、開発されたプリント基板メッキバリ面取り機装置です。

特徴 Features

- 1 0.1mmの薄板基板からバリ取り加工が可能になりました。
- 2 ソフミックス独自の切削位置決め方法で0.1mmの切削加工が可能になりました。
- 3 カッターの加工調整は交換、カッターデータ登録だけで全てパソコンから管理されます。
- 4 コーナーアール加工が0.1mm薄板基板から可能になりました。
- 5 加工履歴、アラーム履歴が自動で管理されています。
- 6 バーコードリーダーを使用した、加工プログラムの変更で操作ミスを防止できます。
- 7 すべてのオペレーションは集中パソコンから行えます。



カッターユニット部 / 基準ガイド部 Cutter / Guide

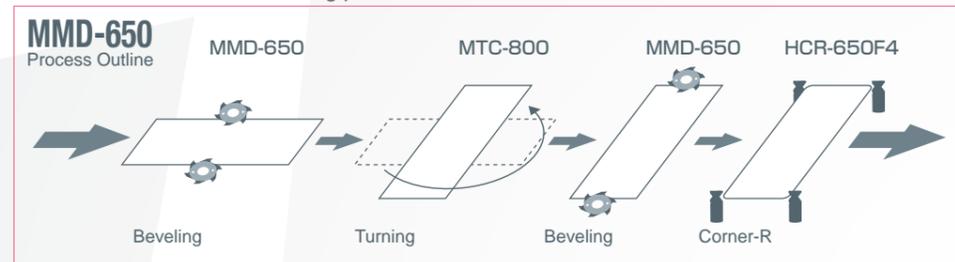


ソフミックス独自の基板外形位置決め手段でメッキされた端面の0.1mm切削が可能になりました。



フルオープンが可能のため、カッターの交換が容易にできます。

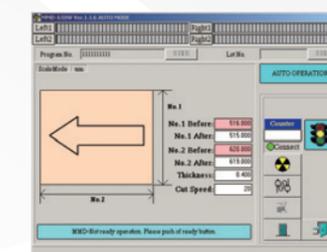
加工の流れと状態 Cutting process



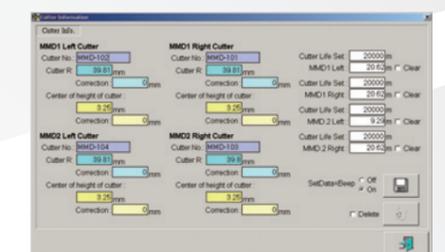
刃物リスト Tool Information



操作画面 Operation



Windows/パソコン画面でデータ入力。ライン一括制御・自動運転・簡単操作が実現しました。
The auto-operation of full line can be performed by just data edit in PC Windows.



カッター交換はカッター径を登録することで自動で加工寸法が設定されます。
The cutting size is automatically set by input the cutter radius form.